

小直径楔焊键合铝丝细铝丝 高纯精铝合金键合丝

产品名称	小直径楔焊键合铝丝细铝丝 高纯精铝合金键合丝
公司名称	苏州亿振拓工业物资有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	昆山开发区柏庐南路999号
联系电话	0512-57253738 13306244446

产品详情

小直径楔焊键合铝丝

在竞争日益激烈的电子产品市场，谁能在控制成本的同时更快将产品推向市场，谁就能更靠近成功。贺利氏高纯精铝合金键合丝能帮助您脱颖而出。

亿振拓公司生产的小直径楔焊键合铝丝采用优质AlSi1合金（99%的铝和1%硅），是ALW-29S的品牌旗下产品。其主要应用在汽车、消费电子产品以及计算机。

相比于用于传送电能的粗铝线，细铝丝专用于信号传输和处理。通常用于板上芯片（COB）的应用。LW-29S铝合金丝包括与IC焊盘的铝的兼容性，特别是在细间距应用。它可以轻松在室温环境下键合，节约成本，是高完整性接合的理想方案，同时不损伤敏感设备。ALW-29S的电和热传导性能也十分出色，应用广泛：

与其他供应商不同，键合铝线属于我们的战略核心业务。我们能够将其匹配到我们全面的组装材料程序中，实现更好的可靠性、性能和可操作性。

这可以帮助您加快开发，优化流程，使产品更快地推向市场。

亿振拓小直径楔焊键合铝丝或许正是您在寻觅的解决方案。

优势一览：

适用许多配置，适用各种楔焊应用

优良的导电率和热导率

相对较高的熔断电流

专为板上芯片（COB）的应用开发

均相的化学成分、稳定机械性能和干净光滑的表面，缔造了卓越的粘合性

细间距应用高可靠键合性能，同时与铝金属化封装兼容

以低能量在常温接合，避免损坏敏感设备，同时确保高完整性键合

3种硬度等级，找到最适合您键合工艺的一款

极宽的键合工艺窗口

符合所有主要键合测试标准

符合所有法规要求，包括REACH和RoHS

应用领域：

机动车电子

消费电子产品

计算设备

板上芯片（COB）技术

分立元件的键合（二极管、晶体管、电容器、电阻器）

混合组件键合